

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2026-061

杭州立昂微电子股份有限公司

关于签订项目投资框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**月产 20 万片 12 英寸轻掺衬底片、12 万片 12 英寸硅外延片项目
- **投资金额：**项目意向总投资约 30 亿元
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**

本协议为投资合作基本原则的框架性约定，无需提交公司董事会或股东会审议。所有涉及项目落地的具体权利义务安排，均需待公司完成内部有权决策机构的审议批准程序后另行签署正式投资协议等确认。如需有关部门批准或备案，需经批准或备案后方可实施。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。

- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**

（一）本协议为双方合作基本原则的框架性约定，协议的执行和实施存在不确定性。

（二）本协议约定的项目投资金额、规模与正式协议及实际执行情况可能存在差距，项目实施主体及项目投资总额以实际投资为准。项目实际投入和建设情况待进一步调查评估及分析后确定，并在履行相关决策、审批等程序后方可实施，具有不确定性。

（三）本协议约定的项目投资金额较大，项目建设完成后可能产生较大的固定资产折旧或摊销，在产能爬坡阶段若营业收入规模的增长无法覆盖其资产折旧，则可能对公司的经营业绩产生影响。

（四）公司所处行业技术快速演进，若未能及时跟进或技术方向出现重大变化，可能导致技术落后与产品需求下降的风险。

（五）公司所处行业不排除有更多的竞争者加入，可能会对产品的价格产生不利影响。项目实施完成后可能面临因市场竞争加剧、行业景气度不及预期等多方面不确定因素带来的业绩波动加剧的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

杭州立昂微电子股份有限公司（简称“公司”）与嘉兴市南湖区人民政府于近日签署了《项目投资合作框架协议》（简称“协议”），就公司在嘉兴市南湖区投资建设半导体硅片项目达成合作框架。基于逻辑芯片制造领域客户对外延硅片的旺盛需求，公司轻掺硅片在逻辑芯片、高压 BCD 工艺、PMIC 电源管理等高附加值应用领域形成全系列产品覆盖，为进一步满足客户的外延片需求，完善公司核心产业链布局，公司计划投资“月产 20 万片 12 英寸轻掺衬底片、12 万片 12 英寸硅外延片项目”（以下简称“项目”）。

本协议为双方合作基本原则的框架性约定，无需提交公司董事会或股东会审议。所有涉及项目落地的具体权利义务安排，均需待公司完成内部有权决策机构的审议批准程序后另行签署正式投资协议等确认。如需有关部门批准或备案，需经批准或备案后方可实施。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议的主要内容

甲方：嘉兴市南湖区人民政府

乙方：杭州立昂微电子股份有限公司

甲方为引入符合产业导向的优质实体项目，乙方为进一步完善核心产业链布局，双方协商一致就乙方拟在甲方辖区内投资建设半导体大硅片项目达成合作框架如下：

（一）项目概况

乙方拟在甲方辖区内投资建设“月产 20 万片 12 英寸轻掺衬底片、12 万片 12 英寸硅外延片项目”（以下简称“项目”），项目主要产品包括 12 英寸轻掺衬底硅片以及 12 英寸硅外延片。项目总投资约 30 亿元，固定资产投资约 29 亿元，项目完全达产后预计实现年产值超 13 亿元。

（二）建设安排

项目建设周期为 5 年，乙方依托控股子公司金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司现有厂房，由乙方控股子公司金瑞泓昂芯微电子（嘉兴）有限公司开展项目建设。项目整体推进节奏由乙方自主统筹安排。

（三）政策支持

甲方按照国家、省、市及甲方现行有效的集成电路产业等相关专项政策，给予乙方设备投资补助、贷款贴息、研发投入补助等支持政策，同时积极协助乙方项目争取国家、省、市相关支持政策。甲方同时做好项目电力配套和项目制氢站用地配套等事项。

（四）保密条款

双方应对本协议全部内容及在履行过程中获悉的对方商业秘密承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。法律法规另有规定或有权机关依法要求的除外。

（五）其他

本协议仅为双方合作意向性协议，所有涉及项目落地的具体权利义务安排，均需待乙方完成其内部有权决策机构的审议批准程序后，由双方另行签署正式投资协议等进行确认。

六、对外投资对上市公司的影响

公司 12 英寸硅片产品坚持高端化、差异化发展路线，轻掺硅外延片在逻辑芯片、高压 BCD 工艺、PMIC 电源管理等高附加值应用领域形成全系列产品覆盖，前述产品应用领域与传统轻掺抛光片的技术路径、产品规格等存在不同，客户所需硅片具有外延生长的需求，所需硅片产

品多以 12 英寸轻掺硅外延片的形式出货，市场需求广阔。

公司系国内最早从事半导体硅片研发制造的企业之一，外延工艺可兼容重掺、轻掺两类差异化技术路线，在高端硅片及特殊外延工艺上实现多项重大突破，一批核心技术国内独家掌握。相同尺寸硅外延片平均销售单价显著高于硅抛光片，公司 12 英寸硅外延片产品毛利率较高，目前公司硅外延片订单饱满。在市场需求广阔背景下，公司基于自身工艺技术优势，采用差异化发展路线，加大高附加值 12 英寸硅外延片布局力度，提升高毛利率的硅外延片占比，持续优化产品结构，将有效提升公司的持续经营能力。

金瑞泓昂芯微电子（嘉兴）有限公司目前正在实施“年产 96 万片 12 英寸硅外延片项目”，具体内容详见公司于上海证券交易所官网和公司指定信息披露媒体披露的《立昂微关于拟签署投资协议书暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-008）及《立昂微关于签署投资协议书的进展公告》（公告编号：2025-010），如本次“月产 20 万片 12 英寸轻掺衬底片、12 万片 12 英寸硅外延片项目”实施，金瑞泓昂芯微电子（嘉兴）有限公司将形成月产 20 万片硅外延片（即月产 20 万片轻掺衬底产能+月产 20 万片硅外延产能）的完整生产能力。

如本项目实施，公司将统筹资金安排和投资进度，在建设期内分阶段建设、分阶段投产，资金来源主要依靠自有资金和自筹资金。公司 2024 年度、2025 年度货币资金余额分别为 230,359.69 万元、199,993.05 万元，现金储备充足；2024 年度、2025 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 81,096.60 万元、83,864.40 万元，经营性现金流稳定；公司资产负债率较低。此外公司银行授信额度充足，且根据本协议公司投资将获得设备投资补助、贷款贴息、研发补助等政策支持。因此公司实施本项目每年所需的投资金额不会对公司经营性现金流产生较大影响。

本项目有助于提升上市公司的持续经营能力，契合公司发展战略与长远规划，符合公司全体股东的根本利益。本协议的签署不会对公司 2026 年财务状况和经营成果产生重大影响。

七、对外投资的风险提示

（一）本协议为双方合作基本原则的框架性约定，协议的执行和实施存在不确定性。

（二）本协议约定的项目投资金额、规模与正式协议及实际执行情况可能存在差距，项目实施主体及项目投资总额以实际投资为准。项目实际投入和建设情况待进一步调查评估及分析后确定，并在履行相关决策、审批等程序后方可实施，具有不确定性。

（三）本协议约定的项目投资金额较大，项目建设完成后可能产生较大的固定资产折旧或摊销，在产能爬坡阶段若营业收入规模的增长无法覆盖其资产折旧，则可能对公司的经营业绩产生影响。

（四）公司所处行业技术快速演进，若未能及时跟进或技术方向出现重大变化，可能导致技术落后与产品需求下降的风险。

（五）公司所处行业不排除有更多的竞争者加入，可能会对产品的价格产生不利影响。项目实施完成后可能面临因市场竞争加剧、行业景气度不及预期等多方面不确定因素带来的业绩波动加剧的风险。

后续公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日